

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2023-018

## 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

### 关于公司向银行申请资产抵押贷款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、公司向银行申请资产抵押贷款概述

2021年1月19日召开股东会，经股东大会审议通过《关于公司向银行申请资产抵押贷款的议案》决定，同意向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币贰亿伍仟万元的固定资产贷款额度，期限不超过伍年，并同意以本公司自有资产肇庆高新区沙沥工业园创业路东面、兴旺河南面城市地带工业用地的土地使用权（不动产权证编号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第0000834号）提供抵押担保。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年3月30日、2022年4月22日分别召开第一届董事会第十六次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度公司（及子公司）向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向各大银行申请不超过5亿元人民币的授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）；同意公司以其资产作为抵押为公司向银行贷款提供担保；有效期自公司股东大会审议批准之日起一年。

具体内容详见公司于2022年3月31日和2022年4月22日披露于巨潮资讯网的《2022年度公司（及子公司）向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-006）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-015）。

#### 二、公司向银行申请资产抵押贷款的进展情况

2022年2月9日，公司与招商银行股份有限公司佛山分行签订了《授信协议》（编号：757XY2022004264），约定向公司提供2.5亿元人民币的授信额度，授信期间为60个月。

2022年2月9日，公司与招商银行股份有限公司佛山分行签订了最高额抵押合同（编号：757XY202200426401），公司以位于肇庆高新区沙沥工业园创业路东面、兴旺河南面工业用地的土地使用权（不动产权证编号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第0000834号）作为抵押物为上述《授信协议》项下贷款提供最高额抵押担保。

因经营发展需要，公司拟与招商银行股份有限公司佛山分行重新签订最高额抵押合同（编号：757XY202200426402），为上述《授信协议》项下贷款变更抵押物，变更后的抵押物为原已签署的最高额抵押合同（编号：757XY202200426401）项下土地上盖建筑物。本次变更后抵押物具体明细如下表所示。

### 三、变更抵押物所对应的合同主要内容

**抵押权人：**招商银行股份有限公司佛山分行

**抵押人：**金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

**抵押物：**不动产

序号	抵押物名称	评估价值	处所	权利（属）编号	权属证明
1	不动产	3,089,671.19	肇庆高新区创业路15号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司公用工程楼	粤（2022）肇庆大旺不动产权第0017618号	不动产权证书
2	不动产	23,245.49	肇庆高新区创业路15号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司门卫A	粤（2022）肇庆大旺不动产权第0017619号	不动产权证书
3	不动产	107,324.90	肇庆高新区创业路15号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司门卫B	粤（2022）肇庆大旺不动产权第0017620号	不动产权证书
4	不动产	191,694,882.72	肇庆高新区创业路15号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司综合车间	粤（2022）肇庆大旺不动产权第0017621号	不动产权证书
5	不动产	55,084,875.70	肇庆高新区创业路15号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司综合楼	粤（2022）肇庆大旺不动产权第0017622号	不动产权证书

以上抵押标的评估值合计为人民币2.5亿元，账面值为人民币21,824.27万元，账面值占公司最近一期经审计总资产的31.55%，评估值占公司最近一期经审计

总资产的36.14%。除本次抵押外，上述抵押物不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

#### 四、备查文件

1、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司与招商银行股份有限公司佛山分行签订的《最高额度抵押合同（编号：757XY202200426401）》；

2、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司与招商银行股份有限公司佛山分行签订的《最高额度抵押合同（编号：757XY202200426402）》；

3、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司与招商银行股份有限公司佛山分行签订的《授信协议（编号：757XY2022004264）》。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2023年2月10日